

버블 메모리의 실체

나 극 환*

■ 차

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 1. 서 론 | 4. Magnetic Bubble 이 이동하는 메커니즘 |
| 2. 버블메모리의 동작원리 | 5. 버블메모리의 설계 |
| 3. 버블메모리의 내부구조 | 6. 결 론 |

1. 서 론

1967년 Bell Telephone 연구소에서 처음으로 발표된 이후 오늘날 버블 메모리는 집적 메모리 계열 중 새로운 분야로서 매우 각광을 받고 있다. 종래의 집적 메모리 소자에 비해 비교적 짧은 access time과 아주 높은 집적도, 그리고 기계적으로 움직이는 부분을 필요로 하지 않는 특성으로 인해 버블 메모리는 특히 마이크로 시스템에 가치가 있는 것으로 인정되고 있다.

이 기억 소자들은 비휘발성인 자기 메모리이기 때문에 magnetic tape나 수 Maga bits의 용량을 갖는 magnetic disk(floppy disk)들을 대체 할 수 있는 가능성을 주고 있다. 이것이 상품화 된 것으로는 1977년 Texas Instruments에서 나온것이 있는데 이것은 92,304 bits의 용량을 가진 것이었다.

1979년에는 Intel에서 1 mega bits의 용량을 가진 버블 메모리 IM 7110을 내어 놓았으며 현재에는 더욱 큰 용량에 가격 면에서도 현저하게 낮은 것들이 나오고 있다.

이 버블 메모리가 사용될 수 있는 분야들은 상당히 다양하여 intelligent terminals, 주변장치에 대한 Memory tampon, 전자계임, 산업공정제어, 기억

* 光云工大 電子工學科 助教授

장치를 갖춘 타자기, 휴대용 진료 데이터 기억 장치 등등이 있다.

이제 이 기억 소자의 기본적인 동작원리를 알아보기로 한다.

2. 버블 메모리의 동작원리

버블 메모리의 기본원리는 어떤 단결정 자성체 물질들은 아주 가는 자계에 의해 국부적으로 자화 된다는 사실에 있다.



그림 1. 자성체 박막의 모형

외부적인 자계가 없을 시에는 그림 1과 같이 자성체 박막은 자계 에너지가 최소가 되는 방법으로 random하게 polarize되어 있다.

박막에 수직한 방향으로 자계를 걸으면 그점의 di-

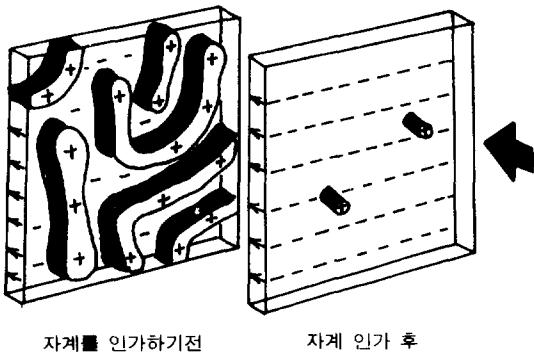


그림 2. 자성체 박막의 상태

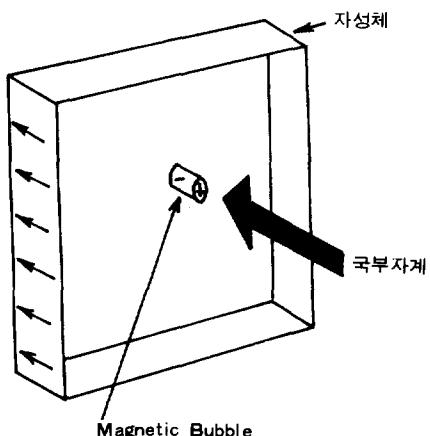


그림 3. 자기 버블의 발생

pole은 인가자계와 같은 방향으로 배열된다.

그 모양은 아주 작은 disk와 같으며 전체적으로는 원통형을 갖는다. (그림 3) 그 직경은 약 $10\ \mu\text{m}$ 이내로서 그 주위의 영향을 받지 않는다.

이와같이 국부적으로 polarize 된 작은 원통을 지우거나 또는 random하게 배열되어 있던 구역을 반대방향으로 polarize 시키기 위해서는 당연히 반대방향으로 강한 자계를 인가해야 한다.

이 작은 원통형의 magnetic dipole이 꼳 bubble이며 이것이 있는 것은 "1", 없을때를 "0"으로 간주한다. 박막에 수직으로 걸어주는 자계 임펄스는 자성체 박막위에 덮힌 도체로 된 미세한 나선에 임펄스 전류를 흘려서 얻는다. 실질적으로는 이 버블 메모리의 총체적인 구성은 이를 bubbles을 발생시키거나 지우며 검출 또는 이동시키도록 되어있어 bubble register를 이루게 된다. 이와같은 버블 메모리의 초

기형태의 내부구조를 다음에 간단히 기술하여 이러한 소자를 사용함에 있어 이해를 돋보자 한다.

3. 버블 메모리의 내부구조

버블 메모리는 세 부분으로 크게 나눌 수가 있는데 하나는 칩 메모리라고 말할 수 있는 얇은 판이고 두 번째는 그 얇은 판을 감고 있는 두개의 bobbin 코일로서 이것은 박막 표면에 회전자계를 주어 bubble이 shift 되도록 하게 하는 것이며 마지막으로 이와 같이 만들어진 메모리가 비휘발성이 되게 하기 위해 정자계를 발생시키는 한쌍의 영구자석판이 있다(그림 4)

(1) 칩메모리

얇은 판으로 되어있는 이 부분은 여러 층으로 되어 있다.

* 맨 밑에 있는 층은 substrate로서 반자성체 단결정 재료로 되어 있는데 이것은 그 위에 자성체 박막을 지지해야 하는 관계로 열적으로 파괴됨을 막기 위해서는 그 자성체 박막과 비슷한 열팽창계수를 갖고 있어야 한다. 가장 잘 사용되는 재료로는 Grenat d'oxyde de Gadolinium et de Gallium(GGG)라고 하는 $\text{Dy}_3\text{Ga}_5\text{O}_{12}$ 가 있다.

* Substrate 위에 덮힌 층은 자성체 박막으로서 이것은 액상에피택시(LPE)로 성장되며 그 두께는 bubble의 직경과 거의 같은 수 micron정도로 한다. 이 자성체 박막에는 일반적으로 $\text{A}_3\text{B}_5\text{O}_{12}$ 와 같은 형의 Europium 산화물 또는 Ytterbium 산화물 등이 사용된다. (그림 3 참조)

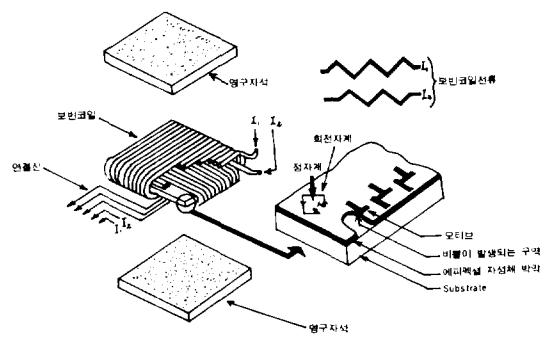


그림 4. 버블 메모리의 구성

이들 재료는 모두 비동방성 자성체로서 monoaxial magnetization 특성, 즉 다시말하여 기본적인 자기 다이폴이 polarization될 때 지향 할 수 있는 단

한개만의 축을 갖고있고 이 자기 다이폴의 축은 자성체 박막에 수직하게 되어야 한다.

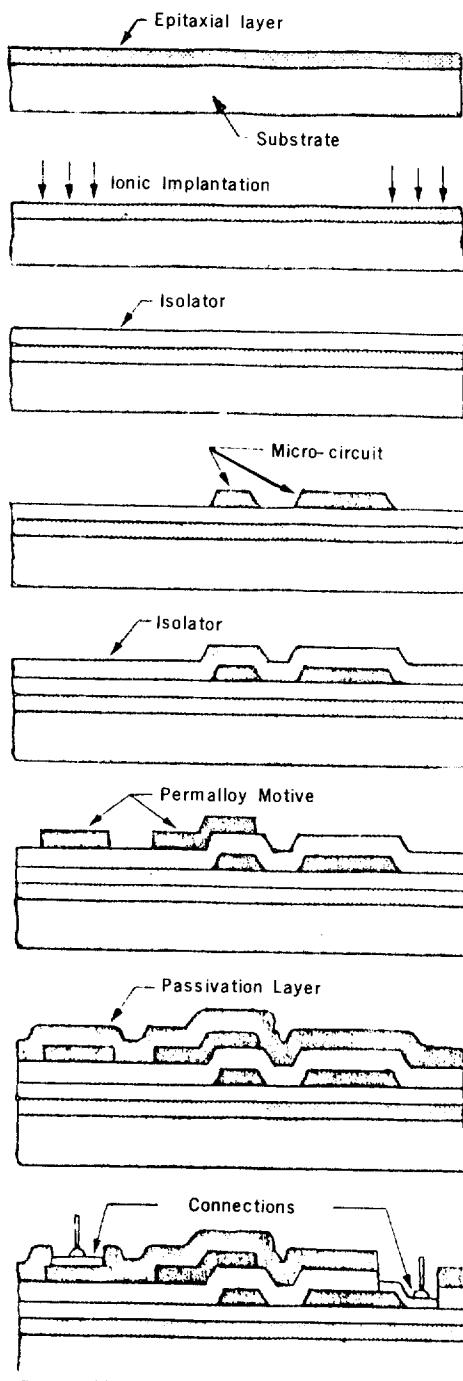


그림 5. 칩 메모리의 제조 공정

다음에는 이 자성체 박막에 실리콘 산화물을 입혀 그 위의 층과 전기적으로 차단한다.

* 절연층위에 알루미늄을 입히고 사진석판으로 micro circuit를 구성하여 이 도체층에 의해 bubble이 발생되거나 지워지고 이동하게끔 한다.

이 층은 그 외에도 bubble의 감지 또는 증폭까지도 하도록 되어 있다.

* 마지막으로 다시한번 절연층을 진공증착시킨 다음 쉽게 자화할 수 있는 합금인 permalloy로 된 motives를 입히는데 이의 형태는 TI 형, Y 형, 근접 disk 형 등으로 할 수 있다.

이 Motives 가 하는 역할은 두개의 세어용 bobbins에 의해 발생된 회전자계에 따라 polarization이 다르게 되고 다시 이 Motives 의 polarization에 의해 magnetic bubble이 그 Motive 상을 또는 Motive 와 Motive 사이를 자계의 세기의 기울기에 따라 이동하도록 하도록 하는 것이다.

(2) 보빈 코일

두개의 보빈코일은 칩메모리판을 감고 있는데 이들이 감긴 축은 서로 직각으로 되어 있고 그들을 흐르는 전류는 그림 4에서 보는 바와같이 삼각파형으로 두 전류는 위상이 90° 어긋나게 되어 있다. 이들에 의해 발생되는 자계를 합성해 보면 그 결과는 그들의 위상에 따라 칩메모리 표면을 회전하는 자계를 얻을 수 있다.

(3) 영구자석

앞에서 언급한 칩메모리와 보빈코일을 결합한 시스템 외부에 상하로 두개의 영구판 자석이 있는데 이들은 정자계를 발생시켜 magnetic bubble이 있는 구역의 안정도를 높이어 메모리의 비휘발성을 유지 시킨다.

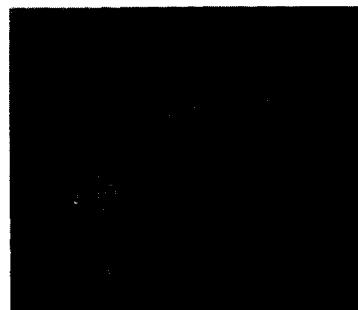


그림 6. 버블 메모리판과 영구자석의 모형

아직도 이 불편한 한쌍의 자석을 제거할 수 있는 방안이 연구되고 있다.

4. Magnetic Bubble 이 이동하는 메카니즘

micro circuit 를 흐르는 임펄스 전류에 의해 생성된 마그네틱 버블은 permalloy 로 된 모티브들 중 가장 가까운 하나에 포착이 된다.

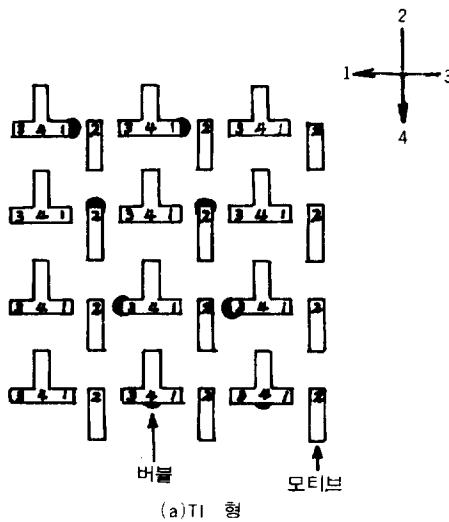


그림 7. 여러가지 형태의 퍼밀로이 모티브

그 bubble 은 자기인력 또는 반발력에 의해 한 모티브로부터 다른 모티브로 건너 뛰면서 그들 permalloy 모티브에 의해 지정된 코스를 따라간다.

이와같이 bubble 이 이동하는 원리는 자화된 부분

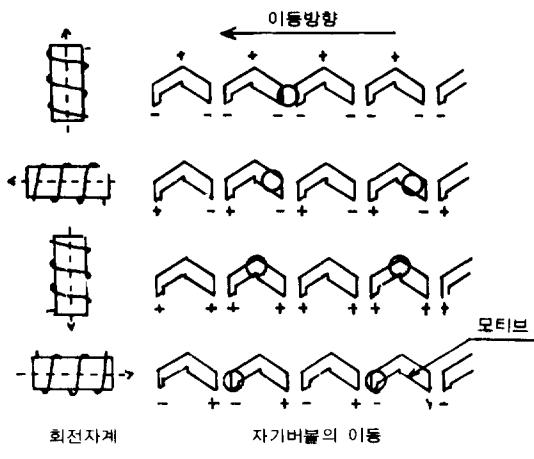


그림 8. 자계 버블의 이동 상태

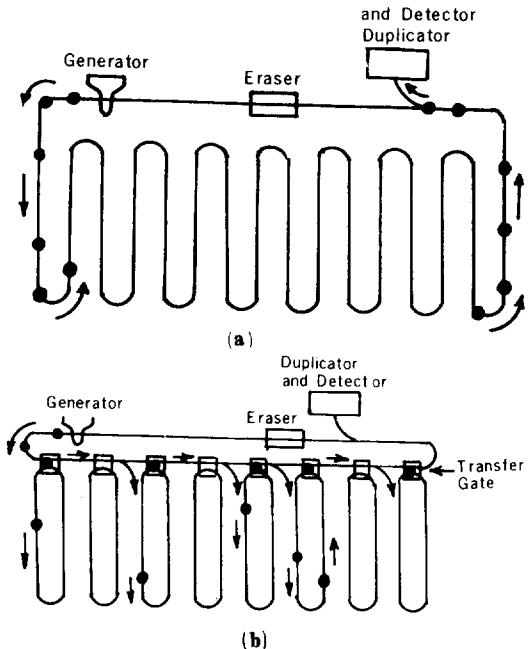


그림 9.

이 공간적으로 변화있는 자계, 즉 경사가 있는 자계 내에 위치해 있을 때, 다이폴이 가장 polarization 되기 쉬운 구역으로 이동하여 그 포텐셜 에너지가 최소가 되는 점에 위치하게 되는 사실에 있다.

이와같은 bubble 의 이동에 필요한 에너지는 아주 작아서 bubble 의 직경의 4 배 정도를 이동하는데 4×10^{-14} Joules 이면 충분하다.

그 이동속도는 자계의 경사에 비례하게 되어 두점 사이의 자계의 차이가 크면 클수록 속도는 증가한다.

이들 bubble 의 이동 상태는 편광된 광원 하에서

는 눈으로도 볼 수 있는데 이것은 실제로 물질이 이동하기 때문이 아니고 자성체 박막내의 자기 디아풀들이 점진적으로 회전하면서 이동하는 것처럼 환상을 주기 때문이다.

자체의 경사는 두개의 보빈코일에 의해 발생된 회전자계에 의해 자화된 퍼밀로이 모티브에 의해 주어지는 것으로 이에 의해 bubble 들은 모티브의 한 끝점에서 인접 모티브의 끝점으로 위치를 옮겨간다. 따라서 회전자계가 한 바퀴 돌면 bubble 은 한개의 모티브를 완전히 이동한 것이다.

5. 버블 메모리의 설계

버블 메모리 제작에서 사용될 수 있는 두가지 설계 방법에 대해 알아본다.

첫번째 방법은 비교적 간단한 것으로 고리에 끼워진 것처럼 아주 긴 Register 의 직렬구조로서 이러한 구조는 두가지 단점을 갖고 있다. (그림 9 (a))

한 가지는 자기 테이프와 마찬가지로 정보의 access time 이 아주 긴 것이라 볼 수 있고, 또 하나는 이런 종류의 메모리 제작상의 불완전성으로부터 발생되는 문제로 모든 데이터가 직렬로 기억되게 되므로 그 메모리 chain 중에 단 한개의 결함이 있어도 사용이 불가능하게 된다. 따라서 이러한 구조를 가진 메모리를 생산 하려면 그 공정의 충실도가 아주 높아야 되고 결국 이 방법은 잘 사용되지 않는다. 가장 잘 사용되는 방법은 Serial – parallel – serial 구조이다.

그림 9 (b)에서 보여진 바와 같이 이 구조에서는 테이타가 이동할 수 있는 major loop 가 있고 그를 따라서 여러개의 secondary loop 가 위치해 있어 실제 데이터가 직렬로 저장될 수 있게 되어 있다.

major loop 와 secondary loop 는 window 또는 Transfer gate 라 할 수 있는 점으로 연결되어 있어 이 window 를 통해 데이터가 major loop 와 secondary loop 사이를 왕복할 수 있도록 되어 있다. major loop 는 secondary loop 상의 데이터를 읽거나 쓸 때에 셔터 역할을 한다.

데이터들은 major 또는 secondary loop 상에서 모두 직렬로 배열되게 되지만 그들 사이의 이동은 병렬로 되기 때문에 serial – parallel – serial 이란 이름이 붙여졌다. 앞에서 언급한 바와 같이 회전자계의 매 회전마다 bubble 은 loop 내에서 한구간 이동하므로 synchronous shift Register 로 볼 수도 있다.

정보를 저장하기 위해서는 직렬로 된 데이터가 차제가 한번 회전할 때마다 한 bit 씩 major loop 에 보내진다. 이를 데이터의 bits 가 각각 지정된 window 에 이르면 모든 window 상을 가로질러 위치해 있는 micro circuit 에 강한 임펄스가 훌러서 이 전류가 발생시키는 순시 자체에 의해 각각의 window 에 있는 bubble 들의 이동방향을 secondary loop 로 향하도록 한다. 따라서 데이터를 저장하기 전 반드시 메모리를 깨끗이 지워야 하므로 major loop 에 bubble eraser 를 두어 이를 수행한다.

정보를 읽어내는 과정은 다음과 같다. 먼저 secondary loop 에 저장되어 있는 데이터가 각각의 window 에 나타날 때를 기다린 다음 major loop 로 이동하는 명령을 보낸다. 그러면 데이터들은 major loop 를 돌아 dupicator 에서 한 bit 씩 일회지게 되고, 읽혀지고 난 데이터는 다시 major loop 를 돌아 원래의 위치로 돌아와 메모리가 원래의 데이터를 계속 유지시킬 수 있도록 한다. dupicator 에서 복제된 각각의 bit 는 일단 층폭이 되어 자기 저항 검출기에 보내진다.

bubble 의 존재 유무는 검출기의 저항의 증감에 의해 검출될 수 있다. 즉 bubble 이 있으면 저항이 감소하여 그를 흐르는 전류가 증가하게 되는데 이와같이 얻어진 신호는 전송되기 전에 층폭을 거쳐 파형 정형이 된 다음 Read / write 의 logic system 에 보내지게 된다. 이러한 구조는 magnetic disk 와 흡사한 면이 있다. major loop 는 disk 상을 움직이는 헤드와 같은 역할을 하는 것으로 그 loop 상의 각 점들은 secondary loop 와 연결되어 있다. 이 버블 메모리의 제조공정은 매우 정교하여야 하며 일반적으로 yield 가 상당히 낮다.

이러한 제작상의 단점을 해결하기 위하여 실제로 제작자들은 가능한 불량 포함률을 고려하여 메모리의 크기를 증가시키는 방법을 택하고 있다. 제작의 마지막 공정에서 이를 메모리는 이상유부 시험을 거쳐 반일 결합이 있으면 결합이 있는 부분을 명시하여 사용자가 그 부분을 피하여 사용하도록 하기도 한다.

6. 결 론

이 버블 메모리는 기존 기억 소자들의 진화된 형태라든가 또는 그들을 대체할 소자라기 보다는 차라리 아주 흥미 있으며 이미 널리 사용되고 있는 기존 기억 소자들과는 다른 특성을 가진 새로운 집적 기억소

자라고 말할 수 있을 것이다. 이 새로운 기억소자의 두드러진 특성을 들자면 다음과 같다.

- * 비교적 짧은 access time

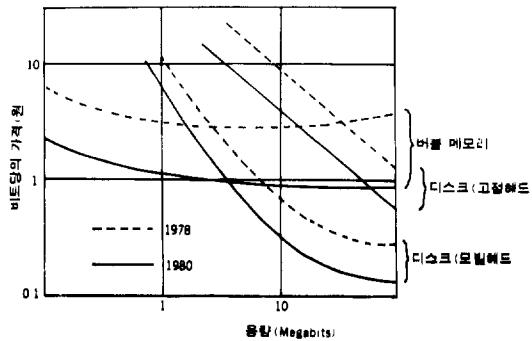


그림 10. 용량에 따른 기억소자의 가격

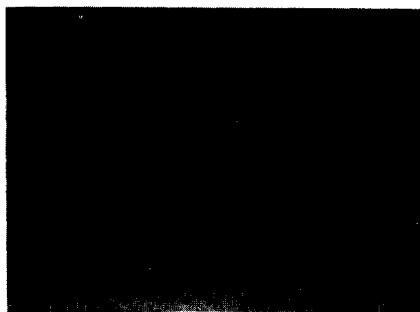


그림 11. TIB 0303 (256 k - bits)
Texas Instruments



그림 12. 확대된 버블 메모리

	집적도 (k-bit/cm)	액세스 타임 (msec.)	전력소모 (microwatt/bit)	가격 (원/bit)
Bubble Memory	2.4	4	0.1	0.25
Disk(Fixed Head)	0.09	8	88	0.50
Floppy Disk	0.2	300	23	0.09
Cassette	0.24	35	8	0.06

그림 13. 여러가지 메모리 소자의 비교

- * 아주 높은 집적도
 - * 움직이는 기계부분이 없다.
 - * maintenance 가 필요없고 충실도가 높다.
- 다른 집적기억소자들과 비교해 볼 때 이 버블 메모리는 수 mega - bits 를 넘지 않는 기억소자의 시스템에 있어 가격면에서 우수한 장점을 갖고 있는데 이 것은 이 소자를 사용함에 있어 비싼 기계적인 시스템이 필요하지 않다는 사실만으로도 알 수 있다.